

平成26年度

推進研究プロジェクト成果報告会・特別講演会

—次世代先進半導体加工・システム実装・高集積複合MEMS製造技術開発—

日時：平成27年3月6日(金) 13:00～17:30

場所：茨城大学工学部

総合研究棟(E5棟) 8階イノベーションルーム

参加費：無料

【プログラム】

13:00～13:15 プロジェクトリーダー挨拶(前川 克廣)

13:15～14:15 特別講演



「スーパーインクジェット技術を用いたオンデマンド微細加工」

株式会社SIJテクノロジー

代表取締役社長 村田 和広氏

【休憩】

14:30～15:30 成果報告Ⅰ(極限加工グループ)

14:30～15:00 ○「次世代半導体加工グループの成果報告

～ウェハ計測技術～」 小貫哲平

15:00～15:30 ○「ウェハ研削加工技術に関する研究

～研削砥石のモデル化と砥粒切れ刃の三次元分布～」

蛭名雄太郎(周立波)

【休憩】

15:45～17:35 成果報告Ⅱ(MEMS/システム実装グループ)

15:45～16:15 ○「シリカコート金ナノ粒子のレーザ焼結技術」 山崎和彦

16:15～17:15 ○「オンデマンド高速レーザめっき技術とその応用」 前川克廣

17:15～17:30 閉会挨拶(周立波)

18:00～19:00 懇親会(E5棟 8階イノベーションルーム

／工学部生協(仮)

お問合せ先：茨城大学工学部 機械工学科

TEL:0294-38-5278(山崎)

*講演者、講演タイトル、講演時間は変更になる場合があります。

